



Title of Change:	FODM8801x and FOD8802x: Alternate wafer manufacturing site and alternate LED die source.
Proposed First Ship date:	20 Aug 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Esther.Lau@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or ChangKit.Mok@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	2142
Change Category:	Alternate die source
Change Sub-Category(s):	NA

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites

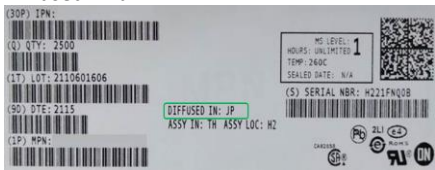
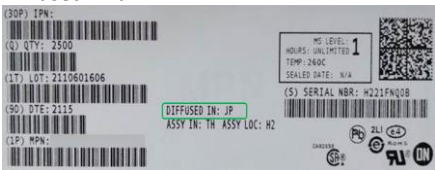
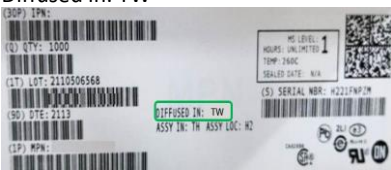
None

External Foundry/Subcon Sites

External Subcon

Description of change:

To introduce an alternate LED die source from the current supplier from a different wafer manufacturing site in Japan (JP) and another die source from another supplier in Taiwan (TW). The changes are summarized as follow:

Item	Before Change (Change From)	After Change (Change To) Add as Alternate I	After Change (Change To) Add as Alternate II
1	LED die source from Supplier A at wafer fab site, X in Japan. MPN Label: Diffused in: JP 	LED die source from Supplier A at wafer fab site, Y in Japan. MPN Label: Diffused in: JP 	LED die source from Supplier B in Taiwan MPN Label: Diffused in: TW 
2	LED size: 260 (L) x 260 (W) x 190 (H) um Bonding pad: 120um	LED size: 260 (L) x 260 (W) x 190 (H) um Bonding pad: 120um	LED size: 230 (L) x 230 (W) x 175 (H) um Bonding pad: 140um

**Reason for change:**

The qualification of the alternate manufacturing site for existing die and alternate LED die source is for flexible manufacturing planning and continuity of supply.

This change will have no impact on quality, reliability, electrical and the product will remain fully compliant. There will be no datasheet changes. Product incorporating both changes will be shipped interchangeably with existing unchanged products.

Reliability Data Summary:**Reliability summary: Alternate wafer manufacturing site**

QV DEVICE NAME: FODM8801A
RMS: 2011000949
PACKAGE: MFP-4

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

Reliability summary: Alternate LED source

QV DEVICE NAME: FODM8801A
RMS: 2010000499
PACKAGE: MFP-4

Test	Specification	Condition	Interval	Results
ELFR	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	48 hours	0/2400
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FODM8801CR2V	FODM8801A
FOD8802B	FODM8801A
FOD8802D	FODM8801A
FOD8802DR2	FODM8801A
FOD8802CR2	FODM8801A
FOD8802C	FODM8801A
FOD8802BR2	FODM8801A
FOD8802AR2	FODM8801A
FOD8802A	FODM8801A
FODM8801CV	FODM8801A
FODM8801CR2	FODM8801A
FODM8801C	FODM8801A
FODM8801BV	FODM8801A
FODM8801BR2V	FODM8801A
FODM8801BR2	FODM8801A
FODM8801B	FODM8801A
FODM8801AV	FODM8801A
FODM8801AR2V	FODM8801A
FODM8801AR2	FODM8801A
FODM8801A	FODM8801A

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

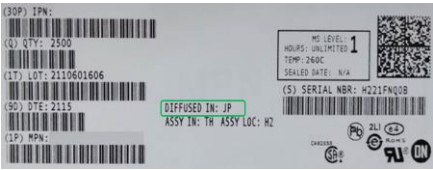
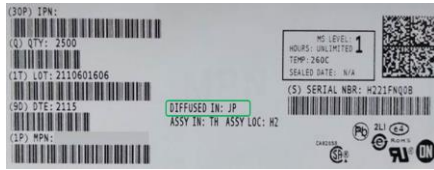
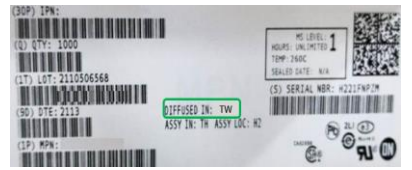
注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	FODM8801x 及び FOD8802x: 代替ウエハ製造拠点と代替 LED ダイ供給
初回出荷予定日:	20 Aug 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Esther.Lau@onsemi.com > にお問い合わせください。
サンプル::	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、イニシアル PCN またはファイナル PCN の初回通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < ChangKit.Mok@onsemi.com > にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。
変更部品の識別:	2142
変更カテゴリ:	代替ダイソース
変更サブカテゴリ:	無し
影響を受ける拠点:	
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
無し	External Subcon

説明および目的:

日本 (JP) の現サプライヤの異なるウエハ製造拠点からの代替 LED ダイ供給、および台湾 (TW) の別のサプライヤから他のダイ供給を導入することが目的です。今回の変更内容をまとめると以下の通りです。

名称	変更前	変更後 代替 I として追加	変更後 代替 II として追加
1	日本のサプライヤ A のウエハ製造拠点 X からの LED ダイ供給。 MPN ラベル: Diffused in: JP 	日本のサプライヤ A のウエハ製造拠点 Y からの LED ダイ供給。 MPN ラベル: Diffused in: JP 	台湾のサプライヤ B からの LED ダイ供給 MPN ラベル: Diffused in: TW 
2	LED サイズ: 260 (L) x 260 (W) x 190 (H) um ボンディング・パッド: 120um	LED サイズ: 260 (L) x 260 (W) x 190 (H) um ボンディング・パッド: 120um	LED サイズ: 230 (L) x 230 (W) x 175 (H) um ボンディング・パッド: 140um

**変更の理由:**

既存のダイの代替製造拠点の認証、および代替 LED ダイ供給源による柔軟な製造計画と供給の継続性のため。

この変更による製品の品質、信頼性、電気的性能、製品への影響はありません。データシートの変更はありません。両方の変更を取り入れている製品は既存の変更がない製品と区別なく出荷されます。

信頼性データの要約:**信頼性の要約: 代替ウエハ製造拠点**

デバイス名: FODM8801A

RMS: 2011000949

パッケージ: MFP-4

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

信頼性の要約: 代替 LED 供給

デバイス名: FODM8801A

RMS: 2010000499

パッケージ: MFP-4

テスト	仕様	条件	間隔	結果
ELFR	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	48 hours	0/2400
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160



電気的特性の要約:

電気的特性に影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FODM8801CR2V	FODM8801A
FOD8802B	FODM8801A
FOD8802D	FODM8801A
FOD8802DR2	FODM8801A
FOD8802CR2	FODM8801A
FOD8802C	FODM8801A
FOD8802BR2	FODM8801A
FOD8802AR2	FODM8801A
FOD8802A	FODM8801A
FODM8801CV	FODM8801A
FODM8801CR2	FODM8801A
FODM8801C	FODM8801A
FODM8801BV	FODM8801A
FODM8801BR2V	FODM8801A
FODM8801BR2	FODM8801A
FODM8801B	FODM8801A
FODM8801AV	FODM8801A
FODM8801AR2V	FODM8801A
FODM8801AR2	FODM8801A
FODM8801A	FODM8801A